

# 120A、90V N沟道增强型场效应管

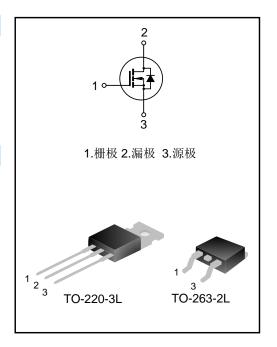
## 描述

SVG095R0NT(S) N沟道增强型功率MOS场效应晶体管采用士兰的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统的电源管理领域。

### 特点

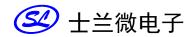
- 120A, 90V,  $R_{DS(on)}$  ( $_{\oplus 20}$  =4.4m $\Omega$ @ $V_{GS}$ =10V
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVG095R0NT	TO-220-3L	095R0NT	无铅	料管
SVG095R0NS	TO-263-2L	095R0NS	无卤	料管

版本号: 1.3 共8页 第1页



# 极限参数(除非特殊说明, T<sub>A</sub>=25°C)

参数			符号	参数值	单位
漏源电压			$V_{DS}$	90	V
栅源电压	栅源电压			±20	V
	T <sub>C</sub> =25°C	芯片电流	I <sub>D</sub>	147	A
漏极电流		封装电流		120	
	T <sub>C</sub> =100°C	芯片电流		100	
漏极脉冲电流    封装电流			I <sub>DM</sub>	480	Α
耗散功率 (T <sub>C</sub> =25℃)			$P_D$	200	W
-大于 25℃ 每摄氏度减少			FD	1.6	W/°C
单脉冲雪崩能量 (注 1)			E <sub>AS</sub>	440	mJ
工作结温范围			T <sub>J</sub>	-55∼+150	°C
贮存温度范围			$T_{stg}$	-55∼+150	°C

# 热阻特性

参数	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{ heta JC}$	0.63	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W

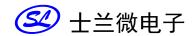
# 关键特性参数(除非特殊说明, T」=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =250μA	90			V
漏源漏电流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =90V, V <sub>GS</sub> =0V			1.0	μΑ
栅源漏电流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±20V, V <sub>DS</sub> =0V			±100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS} = V_{DS}$ , $I_D = 250 \mu A$	2.0		4.0	V
导通电阻	R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =50A		4.4	5.0	mΩ
栅极电阻	$R_{G}$	f=1MHz		3.5		Ω
输入电容	C <sub>iss</sub>			5226		pF
输出电容	Coss	f=1MHz,V <sub>GS</sub> =0V,V <sub>DS</sub> =40V		670		
反向传输电容	C <sub>rss</sub>			24		
开启延迟时间	t <sub>d(on)</sub>	V 40V V 40V D 240		61		
开启上升时间	t <sub>r</sub>	$V_{DD}=40V, V_{GS}=10V, R_{G}=24\Omega,$		80		20
关断延迟时间	t <sub>d(off)</sub>	I <sub>D</sub> =13.3A		228		ns
关断下降时间	t <sub>f</sub>	(注 2,3)		103		
栅极电荷量	Qg	\/ 40\/ \/ 40\/   504		85		
栅极-源极电荷量	Q <sub>gs</sub>	V <sub>DD</sub> =40V, V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =50A (注 2,3)		30		nC
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$	(在 2,3)		21		

版本号: 1.3

http://www.silan.com.cn





# 源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	Is	MOS 管中源极、漏极构成的反偏			120	۸
源极脉冲电流	I <sub>SM</sub>	P-N 结			480	А
源-漏二极管压降	$V_{SD}$	I <sub>S</sub> =50A,V <sub>GS</sub> =0V			1.4	V
反向恢复时间	Trr	I <sub>S</sub> =20A,V <sub>GS</sub> =0V,		66		ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$	dIF/dt=100A/µs (注 2)		0.14		μC

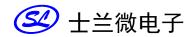
#### 注:

- 1. L=0.5mH, $I_{AS}$ =42A, $V_{DD}$ =72V, $R_{G}$ =25 $\Omega$ ,开始温度 $T_{J}$ =25 $^{\circ}$ C;
- 2. 脉冲测试:脉冲宽度≤300µs,占空比≤2%;
- 基本上不受工作温度的影响。

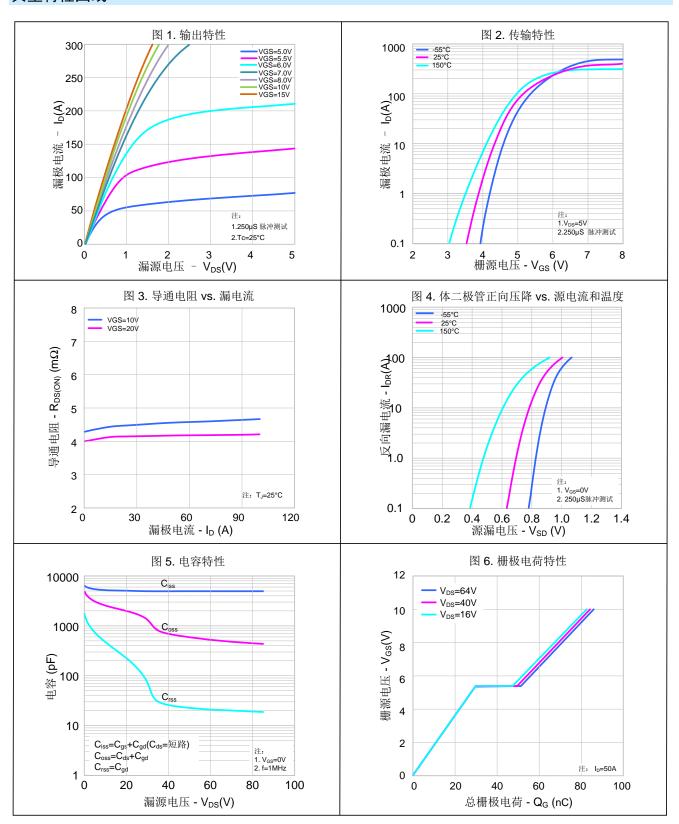
杭州士兰微电子股份有限公司

http://www.silan.com.cn

版本号: 1.3

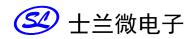


## 典型特性曲线

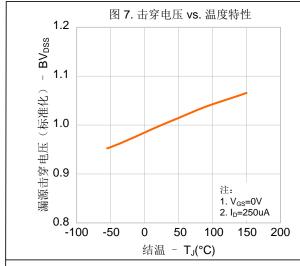


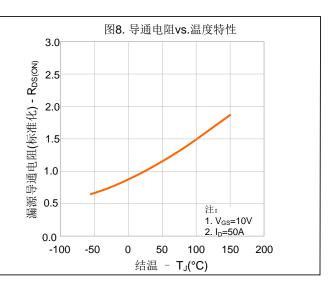
版本号: 1.3

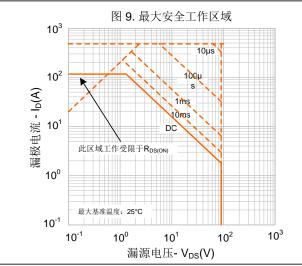
http://www.silan.com.cn



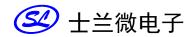
# 典型特性曲线(续)





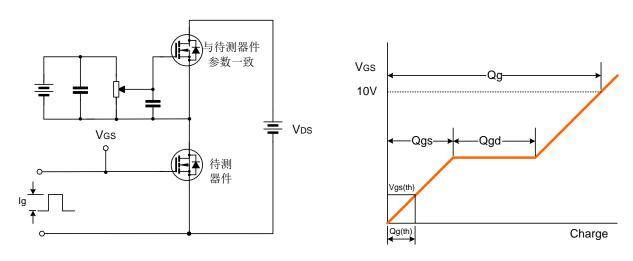


版本号: 1.3 共8页 第5页

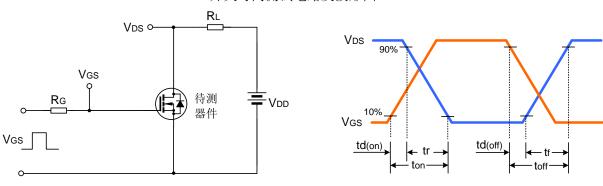


## 典型测试电路

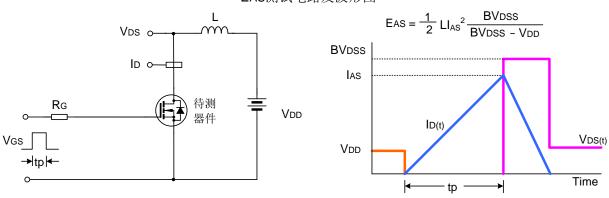
### 栅极电荷量测试电路及波形图



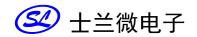
开关时间测试电路及波形图



### EAS测试电路及波形图

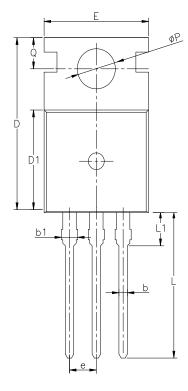


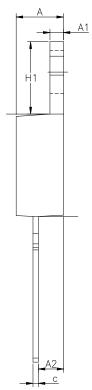
版本号: 1.3



# 封装外形图

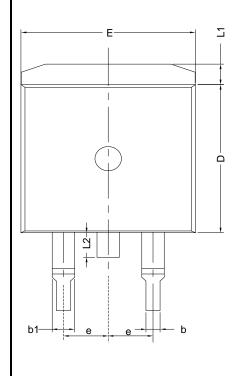


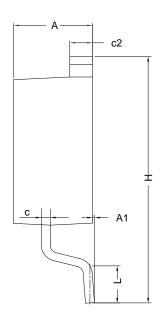




	MILLIMETER				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
Α	4.30	4.50	4.70		
A1	1.00	1.30	1.50		
A2	1.80	2.40	2.80		
b	0.60	0.80	1.00		
b1	1.00	_	1.60		
С	0.30	_	0.70		
D	15.10	15.70	16.10		
D1	8.10	9.20	10.00		
Е	9.60	9.90	10.40		
е		2.54BSC			
H1	6.10	6.50	7.00		
L	12.60	13.08	13.60		
L1	_		3.95		
ΦР	3.40	3.70	3.90		
Q	2.60		3.20		

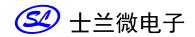
TO-263-2L 单位: 毫米





N/A/DOI	MILLIMETER				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
Α	4.30	4.57	4.72		
A1	0	0.10	0.25		
b	0.71	0.81	0.91		
С	0.30	_	0.60		
c2	1.17	1.27	1.37		
D	8.50		9.35		
Ε	9.80		10.45		
е	2.54BSC				
Н	14.70		15.75		
L	2.00	2.30	2.74		
L1	1.12	1.27	1.42		
L2	_		1.75		

http://www.silan.com.cn



#### 重要注意事项:

- 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料,并验证相关信息是否最新 和完整。
- 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值,否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有 一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 购买产品时请认清我司商标,如有疑问请与本公司联系。
- 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- ◆ 我司网站 http://www.silan.com.cn

产品	名称:	SVG095R0NT(S)	文档类型:	说明书
版	权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.3

修改记录:

1. 更新 TRR 和 QRR

版 本: 1.2

修改记录:

1. 模板更新(更新按比例调整的立体图,更新标准化后的封装外形图,更新曲线模板,更新重要注意事项)

本: 版 1.1

修改记录:

1. 增加 TO-263-2L 封装

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布

杭州士兰微电子股份有限公司